

锦州神工半导体股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2026年9月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 81,028.32 万元（含本数），本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产

收益率下降的风险，具体影响测算如下：

（一）财务指标计算的主要假设和前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境及产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行方案于 2026 年 11 月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设发行数量为 17,030,574 股（以预案出具日公司总股本 170,305,736 股的 10%测算），募集资金总额为 81,028.32 万元，本测算不考虑相关发行费用；本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影响；

5、公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,203.71 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,032.24 万元；

6、假设公司 2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按以下三种假设进行测算：1）较 2025 年减少 10%；2）与 2025 年持平；3）较 2025 年增加 10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

7、假设 2026 年除本次发行外，不存在其他导致公司总股本变化的因素；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年盈利情况的承诺，也不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下：

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	17,030.57	17,030.57	18,733.63
本次发行股份数量（万股）			1,703.06
假设情形一：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年减少 10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,203.71	9,183.34	9,183.34
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,032.24	9,029.02	9,029.02
基本每股收益（元/股）	0.60	0.54	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.54	0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.53	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.53	0.53
假设情形二：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2025 年持平			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,203.71	10,203.71	10,203.71
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,032.24	10,032.24	10,032.24
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.58
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.58
假设情形三：2026 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年增加 10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,203.71	11,224.08	11,224.08

项目	2025 年度 /2025.12.31	2026 年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,032.24	11,035.47	11,035.47
基本每股收益（元/股）	0.60	0.66	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.66	0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.59	0.65	0.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.59	0.65	0.64

注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的实施周期，可能在短期内难以实现预期效益，从而存在本次发行完成后每股收益被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，具有充分的必要性和可行性。

关于本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析，详见《锦州神工半导体股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于主营业务相关项目建设，募集资金投资项目属于围绕现有业务的固有产品及新产品研发、技术

升级与产业化项目，有望进一步丰富公司产品矩阵，提高公司核心竞争力，增强可持续盈利能力，促进公司高质量转型发展。

公司为国内领先的硅材料、硅零部件生产企业之一，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨，以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念，致力于成为有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀半导体材料和半导体零部件供应商。公司将继续着眼于国际半导体行业，引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家；同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员；巩固并加强中国本土技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势。截至 2026 年 6 月末，公司研发人员 85 人，占员工总数的 20.68%，主要研发人员均有丰富的行业工作经验。

技术储备方面，公司聚焦“硅零部件精密加工”、“半导体碳化硅涂层技术”两大核心方向，同步强化工艺智能化管控领域布局，深耕半导体级单晶硅材料及应用产品赛道，研发成果丰硕，专利申请与授权工作稳步推进，进一步夯实了公司“材料+零部件”一体化核心竞争优势，为业务高质量发展提供有力技术支撑。公司在硅零部件上的技术储备十分丰富，已有 20 余项核心技术。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有 111 项专利，其中 22 项为发明专利，89 项为实用新型专利。公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等多项证书，充分证明公司的技术储备及研发实力。

市场储备方面，公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链。公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中，将硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited, TEL），并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商，下游产业链丰富且实力雄厚。同时公司已取得本土硅零部件市场的领先地位，已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子

刻蚀设备制造厂的供应链，以高端品类为主，发挥了独特的国产化作用，市场空间潜力大。

综上所述，公司拥有充足的人员、技术和市场储备，为顺利推进募集资金投资项目提供了充分保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩，为股东持续创造回报，具体如下：

（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范、有效使用

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会决议开设的专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定，在进行募集资金投资项目时，严格履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并及时履行相关信息披露义务。

（二）积极、稳妥地实施募集资金投资项目，实现项目预期回报

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，可有效提升公司业务实力、技术水平，从而进一步巩固公司的市场地位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，

争取早日投产并实现预期效益。

（三）不断完善公司治理，进一步提高经营管理能力

公司已建立健全了内部管理体系，能够保证公司各项经营活动得到有序开展。公司未来将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高经营管理能力，完善决策程序、优化管理流程、强化执行监督，促进公司规范运作，全面提升公司的经营效率和效果，保护公司和投资者的合法权益。

（四）持续完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核

公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用于非经营性活动，提高资金使用效率；严格控制费用支出，加大成本控制力度，降低运营成本，提升公司利润率；加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，保障公司持续、稳定、健康发展。

（五）完善利润分配政策，优化投资者回报机制

公司制定了详细的利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制；在具备现金分红的条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。此外，公司还制定了《锦州神工半导体股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，进一步明确了未来三年（2026-2028 年）的利润分配政策，积极落实对股东的利润分配，促进对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保障投资者的权益。

（六）其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

此外，公司提示广大投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润

做出保证。

六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

- 1、在任何情况下，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对本人的职务消费行为进行约束，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费；
- 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、若公司未来实施股权激励计划，股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、本承诺出具日后，如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的，本人届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；
- 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年9月11日